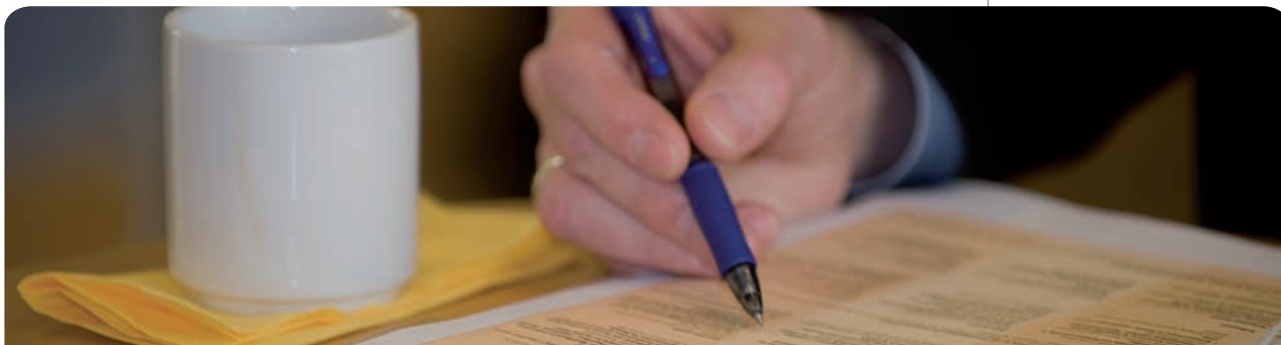


Innovation Forum
München, 27. April 2012

mobil, sicher, vernetzt
Embedded Systems



Unsere Angebote für Sponsoren



2.

„Innovation Forum Embedded Systems“ – mobil, sicher, vernetzt

Unsere Angebote für Sponsoren

Bereits zum vierten Mal veranstaltet BICCnet am 27. April 2012 das „Innovation Forum Embedded Systems“. Das Forum konnte sich inzwischen als Treffpunkt der Branche bestens etablieren. Die Referenten und Besucher, darunter zahlreiche „Stammgäste“, kommen aus ganz Deutschland, um sich über neueste Entwicklungen im Bereich Embedded Systems zu informieren und auszutauschen. Die Teilnehmer stammen aus dem IT-, Elektronik- und Telekommunikations-Umfeld, sind Entwickler und Anwender von Eingebetteten Systemen und aus der wissenschaftlichen Community dieses Bereichs.

Das Konzept, zwischen den Kurzvorträgen viel Raum für Networking vorzusehen, hat sich bewährt, wie das Feedback der letzten Jahre immer wieder zeigte.

Wir bieten Ihnen an, diese etablierte Plattform als Sponsor für Ihr Marketing zu nutzen. Hierfür haben wir drei Pakete zusammengestellt. Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch, um darüber hinaus eine individuelle Lösung für eine Zusammenarbeit zu erarbeiten.

Das Innovation Forum bietet Ihnen als Kooperationspartner die einzigartige Möglichkeit, sich mit aktuellen Themen und Trends einzubringen. Sie zeigen Ihre Kompetenz zum Veranstaltungsthema, können sich in einem hochgradig innovativen Umfeld positionieren und erhöhen Ihren Bekanntheitsgrad. Sie vermeiden Streuverluste und erreichen eine hohe Werbewirkung in Ihrer Zielgruppe. Sie treffen beim „Innovation Forum Embedded Systems“ auf einen hochkarätigen Teilnehmerkreis, den Sie in Ihr geschäftliches Netzwerk integrieren können.

Profitieren Sie vom positiven Imagetransfer dieser Veranstaltung!



27. April 2012

Innovation Forum
Embedded Systems



3.

„Innovation Forum Embedded Systems“ – mobil, sicher, vernetzt

Das Format

Zielgruppe:

Unternehmer • Entwickler • Entscheider • Leiter von Forschungs-, Entwicklungs- und Business Development-Abteilungen • Wissenschaftler • Technologie-Scouts

Ablauf:

Das „Innovation Forum Embedded Systems“ bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich intensiv der Thematik zu widmen. Einen Schwerpunkt des Forums bilden Fachvorträge und Podiumsdiskussionen zu den Innovationstrends in den Bereichen Embedded-Hardware, Embedded-Software und Embedded-Dienstleistungen. Neben der Information über aktuellste Entwicklungen im Bereich Embedded Systems ist das Knüpfen neuer Kontakte über bestehende Branchen, Technologiefelder und Wertschöpfungsketten hinweg ein wichtiger Fokuspunkt. Dafür bietet die Veranstaltung reichlich Raum für informelle Gespräche und Networking.

Technologie-Scouting beim Innovation Forum:

- Vorträge zu innovativen Einsatzgebieten und „Emerging Technologies“
- Überblick über aktuelle F&E-Projekte
- Überblick über aktuelle Kooperationen von Industrie und Wissenschaft

Konvergenz und Relevanz von Embedded Systems für eine Vielzahl von Branchen und Industrien:

Automatisierungstechnik • Automobilbau • Elektro- und Kommunikationstechnik • Luft- und Raumfahrt • Maschinenbau • Medizintechnik • Unterhaltungselektronik





4.

„Innovation Forum Embedded Systems“ – mobil, sicher, vernetzt

Premium Sponsoring

Leistungen während des „Innovation Forum Embedded Systems“:

- Logo auf den Konferenzunterlagen
- 1/1-seitige Anzeige in den Tagungsunterlagen
- Logo auf Displayaufstellern
- Logo auf Leinwänden zwischen den einzelnen Fachvorträgen
- Separater Sponsorenraum für vertrauliche Gespräche inklusive Catering
- Eintrittskarten für 5 Personen

Medialeistungen vor und nach der Veranstaltung:

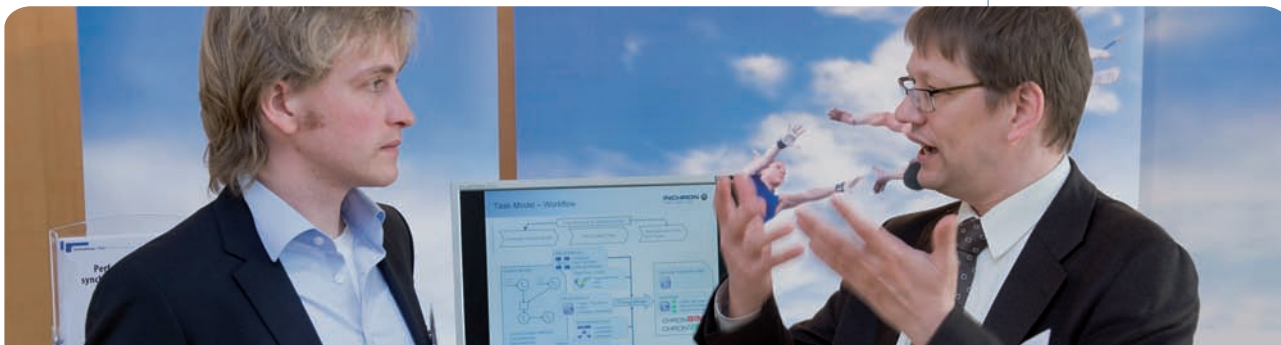
- Online-Werbung auf der Veranstaltungswebseite: www.bicc-net.de/innovationforum2012
- Hinweis auf Ihr Unternehmen in Mailings zur Veranstaltungsankündigung
- Profil Ihres Unternehmens in den Tagungsunterlagen
- Logo auf den Veranstaltungsplakaten
- Logo und Kurzprofil auf der Veranstaltungs-DVD mit den Vorträgen

Premium-Sponsoring Betrag: € 6.000 zzgl. MwSt.

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Kathrin Jaenicke
BICCnet Clusterbüro
Boltzmannstraße 3, 85748 Garching
Telefon: (089) 289-1786 2, Telefax: (089) 289-1786 1
jaenicke@bicc-net.de





5.

„Innovation Forum Embedded Systems“ – mobil, sicher, vernetzt

Co-Sponsoring

Leistungen während des „Innovation Forum Embedded Systems“:

- Logo auf den Konferenzunterlagen
- 1/2-seitige Anzeige in den Tagungsunterlagen
- Logo auf Displayaufstellern
- Eintrittskarten für 3 Personen

Medialeistungen vor und nach der Veranstaltung:

- Online-Werbung auf der Veranstaltungswebseite: www.bicc-net.de/innovationforum2012
- Hinweis auf Ihr Unternehmen in Mailings zur Veranstaltungsankündigung
- Profil Ihres Unternehmens in den Tagungsunterlagen
- Logo auf den Veranstaltungsplakaten
- Logo und Kurzprofil auf der Veranstaltungs-DVD mit den Vorträgen

Co-Sponsoring Betrag: € 3.000 zzgl. MwSt.

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Kathrin Jaenicke
BICCnet Clusterbüro
Boltzmannstraße 3, 85748 Garching
Telefon: (089) 289-17862, Telefax: (089) 289-17861
jaenicke@bicc-net.de





6.

„Innovation Forum Embedded Systems“ – mobil, sicher, vernetzt

Aussteller

Leistungen während des „Innovation Forum Embedded Systems“:

- ca. 3,5 qm großer Stand im Foyer der Vortragsräume (siehe Standplan)
- 1 runder Stehtisch
- 1 Stromanschluß 230 Volt
- 1 Plakat oder Roll-up (mitgebracht vom Aussteller)
- Eintrittskarte für 1 Person

Medialeistungen vor und nach der Veranstaltung:

- Ausstellerverzeichnis auf der Veranstaltungswebseite:
www.bicc-net.de/innovationforum2012
- Profil Ihres Unternehmens in den Tagungsunterlagen
- Vorstellung der Aussteller in einem Mailing
- Logo und Kurzprofil auf der Veranstaltungs-DVD mit den Vorträgen

Aussteller-Betrag: € 1000 Euro zzgl. MwSt.

First come, first served.

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Kathrin Jaenicke
BICCnet Clusterbüro
Boltzmannstraße 3, 85748 Garching
Telefon: (089) 289-1786 2, Telefax: (089) 289-1786 1
jaenicke@bicc-net.de



27. April 2012

Innovation Forum
Embedded Systems